

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2023-057

锦州神工半导体股份有限公司

关于参加 2023 年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议参与方式：投资者通过登录上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>) 参与本次业绩说明会互动交流。

● 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在 2023 年半年度半导体行业专场集体业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度半导体行业集体业绩说明会，此次活动以网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

- (一) 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00

(二) 会议召开方式：网络文字互动

(三) 会议参与方式：投资者通过登录上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>) 参与本次业绩说明会互动交流。

(四) 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)16:00 通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长兼总经理潘连胜先生，董事会秘书、财务总监及副总经理袁欣女士，技术研发总监山田宪治先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、联系人及咨询办法

联系部门：证券办公室

联系电话：0416-7119889

电子邮箱：info@thinkon-cn.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>) 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

2023 年 8 月 26 日